

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:

- 90° orizzontale e 180° verticale
- con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
- Processi di saldatura THT, THR o SMD
- Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
- Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
- Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)

Caratteristiche e vantaggi:

- Intervallo di temperatura ampliato da -40 °C a +85 °C per la massima capacità di prestazioni
- Lato dorato rinforzato (30µ") per una migliore protezione anticorrosione
- Il supporto di almeno 3 mm assicura una perfetta saldatura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RJ45C5 R1V 3.2N4N RL
Nr.Cat.	2562970000
Versione	Connettore per circuito stampato, Jack RJ45, Cat. 5 , Collegamento a saldare THT/THR, 180°, Linguette di schermatura: nessuno, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: No, Numero di poli: 8, Tape
GTIN (EAN)	4050118571998
CPZ	200 Pezzo
Imballaggio	Tape

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	16 mm	Larghezza (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Altezza minima	16,5 mm	Profondità	16,7 mm
Profondità (pollici)	0,657 inch	Peso netto	10 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1,5 A	Resistenza contro l'isolamento	1000 MΩ at 500 V DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	1000 V AC	Tensione nominale	125 V AC

Specifiche di sistema

Angolo di uscita	180°	Cablaggio	8 poli
Categoria	Cat. 5	Cicli di inserimento	750
Diametro foro di equipaggiamento (D)	0,9 mm	Famiglia prodotti	OMNIMATE Data - Jack RJ45
Grado di protezione	IP20	LED	No
Linguette di schermatura	nessuno	Lunghezza spina a saldare (l)	3,2 mm
Materiale della schermatura	Ottone	Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT/THR
Numero di codoli a saldare per polo	1	Numero di poli	8
Passo in mm (P)	1,27 mm	Passo in pollici (P)	0,05 inch
Schermatura	Sì	Superficie di schermatura	nichelato
Tipo di collegamento	Femmina	Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare	+0,5 / -0,5 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)	± 0,1 mm		

Dati del materiale

Materiale isolante	PA 9T	Colori	Nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	II
CTI	≥ 500	Resistenza contro l'isolamento	1000 MΩ at 500 V DC
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base dei contatti	Fosforo bronzo	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Struttura a strati del connettore maschio	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

Imballaggio

Imballaggio	Tape	Lunghezza VPE	0 m
Larghezza VPE	0 m	Altezza VPE	0 m
Diametro Ø bobina nastro (A)	330 mm	Resistenza superficiale	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

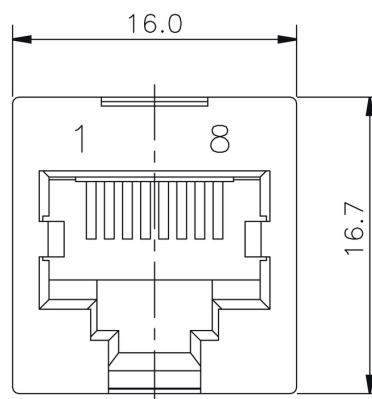
DownloadsDati ingegneristici [STEP](#)

OMNIMATE Data - Jack RJ45 RJ45C5 R1V 3.2N4N RL

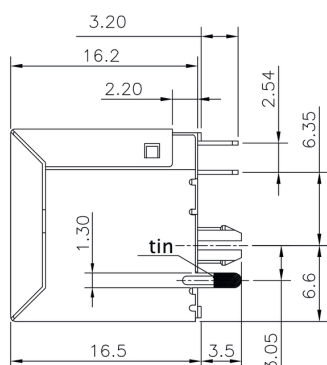
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

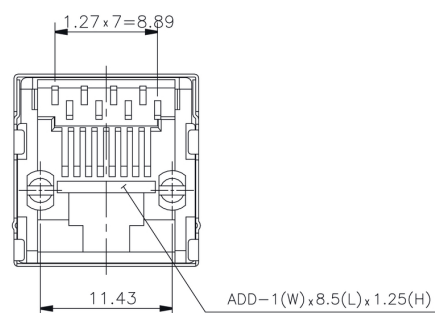
Disegno quotato



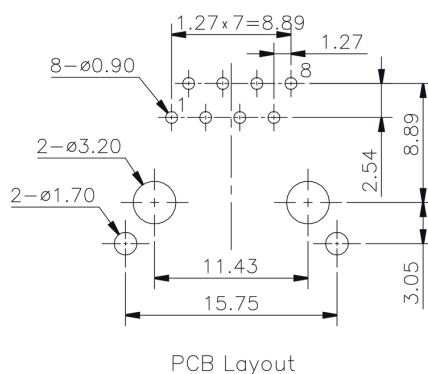
Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno del circuito stampato

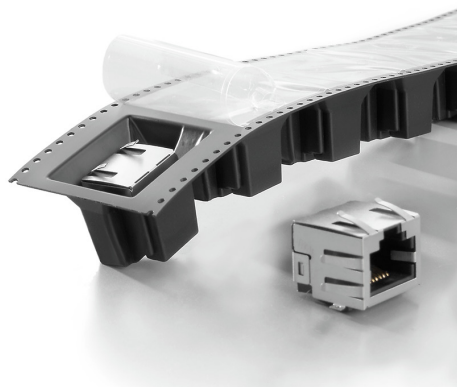


**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Vantaggi del prodotto



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Vantaggi del prodotto

Vantaggi del prodotto



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Data di creazione 12 giugno 2019 7.43.11 CEST

Versione catalogo 07.06.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Legenda

RJ45	G	R	I	U	3	E	4	G/Y/GY	T	J45G1 R1 U3 E4 G/Y/GY T
								Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
								LED	Y/G G/Y GY/GY O/O R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Yellow/Green-Yellow Orange-Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED
								Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
								EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs
								Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD
								Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up
								Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel
								Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
								Performance Category	C5 C6 CSA C5e M G1 G10 U NP NP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.